

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2023-001

广州方邦电子股份有限公司

2022 年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2022 年度实现营业收入为 31255 万元，与上年同期相比，将增加 2008 万元，同比增长 6.87%。

2、预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-6000 万元到-8000 万元。

3、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-7200 万元到-9200 万元。

二、上年同期业绩情况

2021 年度公司实现营业收入为 28619.05 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3507.00 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1682.93 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一) 报告期内，全球疫情起伏反复、经济增长承压、居民部门消费动力不足，全球智能手机终端销售呈现疲软局面，公司主要产品屏蔽膜销量同比出现了约 20% 的下降，销售收入同比下降约 23%。

(二) 报告期内，公司铜箔业务产品主要为锂电铜箔、标准电子铜箔，为过渡性产品，且铜箔客户类型主要为贸易商客户，销售价格低于市场平均水平，铜箔的产能利用率、良率仍低于行业平均水平，同时，二季度和三季度受疫情、产品结构调整等影响销量出现明显下降，全年实现铜箔产品销量约 1600 多吨，未能形成规模效应，叠加相应折旧费用，铜箔生产成本高于行业平均水平，导致铜箔业务出现较大亏损。

(三) 报告期内，母公司总部及生产基地投产，相应折旧等费用增加。

(四) 报告期内，为满足公司未来业务拓展需要，公司持续加大研发投入，由于公司研发产品为基础复合电子材料，应用领域涉及芯片封装、超细线路 FPC 制备以及新能源电池新一代负极集流体等，认证周期长、且生产稳定以及提升良率需要时间，年度内如可剥离铜箔等新产品暂未产生销售。

(五) 非经常性损益影响：本年度公司非经常性损益金额较上年同期减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023年1月31日